****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.es](http://www.congatec.es)  | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Texto y foto también disponible online en:* [*https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html*](https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html)

**Nota de prensa**

Placas congatec con procesador Intel® Core ™ Mobile de
8ª generación y más de 10 años de disponibilidad

**Hasta un 58% de aumento de rendimiento
con disponibilidad ampliada**

**Deggendorf, Alemania, 11 de junio de 2019 \* \* \*** congatec, proveedor líder de placas y módulos embebidos y personalizados, ha anunciado hoy que las nuevas versiones embebidas de los procesadores Intel® Core ™ Mobile de octava generación (con nombre en código Whiskey Lake) están disponibles en los módulos COM Express Type 6 Compact, SBC de 3,5 pulgadas y Thin Mini-ITX. Los clientes OEM se benefician de un aumento de rendimiento instantáneo de hasta un 58%[[1]](#endnote-1) en comparación con los procesadores embebidos de la serie U anteriores, habilitados por 4 en lugar de 2 núcleos más una microarquitectura general mejorada. Gracias a las funciones como la memoria opcional Intel® Optane™ 2 o USB 3.1 Gen2, las tareas diarias son aún más ágiles. Los núcleos del procesador permiten una programación de tareas eficiente y, además, admiten el uso del software de hipervisor RTS para permitir una optimización adicional del rendimiento de E / S de los canales de entrada a los núcleos del procesador.

Diseñadas para entornos difíciles y con espacio limitado, las nuevas placas y módulos de procesador Intel® Core ™ i7, Core ™ i5, Core ™ i3 y Celeron® de gama alta son los primeros en la industria en ofrecer una disponibilidad a largo plazo de 10+ años. Este nuevo principio de diseño de x86 embebido se estrena en congatec y en todo el espacio de proveedores de placas embebidas con el lanzamiento de la nueva octava generación de placas de procesador Intel® Core ™ Mobile[[2]](#endnote-2). En particular, atendiendo a las necesidades de mayor ciclo de vida del sector del transporte y la movilidad, estas nuevas placas y módulos también se adaptan perfectamente a todas las demás aplicaciones embebidas, como equipos médicos y controles industriales, clientes edge embebidos y HMI, ya que permiten unos ciclos de vida útil ampliados sin costes adicionales para los clientes.

"Uno de nuestros principales objetivos es simplificar el uso de la tecnología informática embebida tanto como sea posible para nuestros clientes OEM. Por ello ofrecemos nuestros nuevos módulos y placas embebidas basadas en procesadores Intel® Core ™ Mobile de 8ª generación, ahora con más de 10 años y en base a un contrato de compra de última vez especificado en hasta 15 años de disponibilidad a largo plazo desde el comienzo, ya que 7 años son a menudo insuficientes para muchos sectores de informática embebida de alta gama. Nuestro ciclo de vida ampliado, que, por cierto, viene sin costes adicionales, ayuda a los OEM a ampliar sus propios ciclos de vida de producto para un retorno de la inversión aún mejor", explica Christian Eder, Director de Marketing de congatec.

En el pasado, muchas aplicaciones embebidas de gama alta tendían hacia ciclos de vida inferiores a 7 años, ya que a menudo requerían un nuevo aumento de rendimiento de los procesadores de próxima generación antes de esa fecha. Pero con el aumento de las demandas de certificación en varias áreas nuevas de aplicaciones embebidas, como los vehículos móviles, los OEM están igualmente interesados ​​en los ciclos de vida más largos en la actualidad. La ampliación de los ciclos de vida de las plataformas x86 embebidas estándar a 10 o incluso 15 años fuera de la plataforma es, por consiguiente, una gran ventaja para los clientes en todo el mercado de la informática embebida.

"Estamos muy felices de tener en nuestras manos versiones embebidas de esta nueva arquitectura Intel con más de 10 años de disponibilidad a largo plazo. Los ciclos de vida más largos son un requisito clave en muchas aplicaciones móviles a las que nos dirigimos en entornos resistentes, donde es necesario adquirir y registrar flujos de datos de alta velocidad para el reconocimiento de objetos en 3D, imágenes LIDAR y mapas móviles. El mismo requisito que nuestros clientes finales esperan de nuestros registradores de datos utilizados para la monitorización de redes inalámbricas y sistemas de prueba en automoción o registradores de datos para vehículos de prueba que almacenan y analizan flujos de datos de alta velocidad de sensores externos, en unidades de estado sólido o discos duros", explica Thomas Hagios , CEO de MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH.

**El conjunto de características al detalle**

Los nuevos módulos conga-TC370 COM Express Tipo 6, los SBC conga-JC370 embebidos de 3,5 pulgadas y las placas base conga-IC370 Thin Mini-ITX cuentan con los últimos procesadores embebidos Intel® Core ™ i7, Core ™ i5, Core ™ i3 y Celeron con una disponibilidad a largo plazo de 15 años. La memoria está diseñada para satisfacer las demandas de consolidación de aplicaciones de múltiples sistemas operativos en una sola plataforma: dos zócalos DDR4 SODIMM con hasta 2400 MT / s están disponibles para un total de hasta 64 GB. Por primera vez, USB 3.1 Gen2 con tasas de transferencia de 10 Gbps ahora es compatible de forma nativa, lo que hace posible transferir incluso videos UHD sin comprimir desde una cámara USB o cualquier otro sensor de visión. Los nuevos SBC de 3,5 pulgadas ofrecen este rendimiento a través de un conector USB-C que también admite 1x DisplayPort ++ y fuente de alimentación para dispositivos periféricos, lo que permite la conexión del monitor con un solo cable para video, touch y alimentación. Los módulos COM Express son compatibles con el mismo conjunto de funciones en las placas base. Las interfaces adicionales dependen del factor de forma, pero todas admiten un total de 3 pantallas UHD de 60Hz independientes con hasta 4096x2304 píxeles, así como 1x Gigabit Ethernet (1x con soporte TSN). Las nuevas placas y módulos ofrecen todo esto y muchas más interfaces con un TDP económico de 15W escalable de 10W (800 MHz) a 25W (hasta 4,6 GHz en modo Turbo Boost).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesador** |  | **Cores / Threads** |  | **Base freq. / Max. boost freq.[GHz]** |  | **Base TDP** **[W]** |  | **Rango de temperatura** |
| **Intel® Core™ i7 8665UE** |  | 4 / 8 |  | 2.0 / 3.4 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Core™ i5 8365UE** |  | 4 / 8 |  | 1.8/ 2.6 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Core™ i3 8145UE** |  | 2 / 4 |  | 1.8 / 2.2 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Celeron® 4305UE** |  | 2 / 2 |  | 1.8 |  | 15 |  | 0 to +60°C |

Más información sobre la nueva tecnología del procesador Intel Core de 8ª generación y las correspondientes tarjetas y módulos de congatec en: <https://www.congatec.com/intel-whiskey-lake>

**Sobre congatec**congatec es un proveedor líder de módulos informáticos industriales que utilizan los factores de forma estándar COM Express, Qseven y SMARC, así como ordenadores monoplaca y servicios de personalización. Los productos de congatec se pueden utilizar en varias industrias y aplicaciones, tales como la automatización industrial, médicina, entretenimiento, transporte, telecomunicaciones, prueba y medida, y punto de venta. El conocimiento básico y los conocimientos técnicos incluyen características exclusivas del BIOS ampliado, así como paquetes integrales de soporte para el controlador y la placa. Después de la fase de diseño, los clientes reciben asistencia a través de una amplia gestión del ciclo de vida del producto. Los productos de la compañía son fabricados por proveedores de servicios especializados de acuerdo con los modernos estándares de calidad. Congatec, con sede en Deggendorf, Alemania, actualmente tiene delegaciones en EE. UU., Taiwán, China, Japón y Australia, así como en el Reino Unido, Francia y la República Checa. Más información está disponible en nuestro sitio web en [www.congatec.com](http://www.congatec.com) o via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) y [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel and Intel Core, Celeron are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*

1. As measured by SPECint\_rate\_base2006 N copy on Intel® Core™ i7-8665UE vs. Intel® Core™ i7-7600U

SPEC\* CPU2000/2006 is a benchmark from the SPEC consortium that measures device performance and throughput using compute intensive application subtests.  SPECint\*\_base2000/2006 measures how fast a device completes a single integer compute task.  SPECint\*\_rate\_base2000/2006 measures throughput, or how many integer compute tasks a device can accomplish in a given amount of time.  OS support:  Desktop Windows\*, UNIX\*/Linux\* and Mac\* OS

Full configurations for launch claims: Intel® Core™ i7-8665UE Processor, PL1= 15W TDP, 4C8T, Turbo up to 4.4GHz, Intel® UHD Graphics 620, Intel Reference Platform, Memory: 2x4GB DDR4-2400, Storage: 512GB Intel 545s SSD, OS: Microsoft Windows\* 10 Pro RS5 Build Version 1809 vs Intel® Core™ i7-7600U Processor, PL1=15W TDP, 2C4T, Turbo up to 3.9GHz, Intel® HD Graphics 620, Motherboard: Intel Reference Platform, Memory: 2x8GB DDR4-2133, Storage: 512GB Intel 545s SSD, OS: Microsoft Windows\* 10 Pro RS5 Build Version 1809 [↑](#endnote-ref-1)
2. As far as congatec research of the latest datasheets from all major competitive vendors indicates. [↑](#endnote-ref-2)